证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-012
转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司关于实施“新致转债”赎回暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“新致转债”赎回，公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118021	新致转债	可转债债券停牌	2026/3/20			

● 赎回登记日：2026年3月24日

● 赎回价格：100.8827元/张

● 赎回款发放日：2026年3月25日

● 最后交易日：2026年3月19日

截至2026年3月10日收市后，距离2026年3月19日（“新致转债”最后交易日）仅剩7个交易日，2026年3月19日为“新致转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2026年3月24日

截至2026年3月10日收市后，距离2026年3月24日（“新致转债”最后转股日）仅剩10个交易日，2026年3月24日为“新致转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“新致转债”将自2026年3月25日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.53元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.8827元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“新致转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

公司股票自2026年1月16日至2026年2月5日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即13.69元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价的130%。根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款的相关约定，已触发“新致转债”提前赎回条件。

公司于2026年2月5日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提前赎回“新致转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“新致转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“新致转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条款触发情况

公司股票自2026年1月16日至2026年2月5日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价10.53元/股的130%（含130%），即13.69元/股，根据《募集说明书》的约定，已触发“新致转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2026年3月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新致转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8827元/张。

计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年9月27日至2026年9月26日），票面利率为1.80%。计息天数：自起息日2025年9月27日至2026年3月25日（算头不算尾）共计179天。每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×179/365≈0.8827元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8827=100.8827元/张

（四）赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“新致转债”赎回提示性公告，通知“新致转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年3月25日）起所有在中登上海分公司登记在册的“新致转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（五）赎回款发放日：2026年3月25日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“新致转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

截至2026年3月10日收市后，距离2026年3月19日（“新致转债”最后交易日）仅剩7个交易日，2026年3月19日为“新致转债”最后一个交易日。2026年3月19日收市后，“新致转债”将停止交易。

截至2026年3月10日收市后，距离2026年3月24日（“新致转债”最后转股日）仅剩10个交易日，2026年3月24日为“新致转债”最后一个转股日。2026年3月24日收市后，“新致转债”将停止转股。

（七）摘牌

自2026年3月25日起，公司的“新致转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.8827元（税前），实际派发赎回金额为人民币100.7062元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元可转债实际派发赎回金额为人民币100.8827元（含税）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值100元可转债实际派发赎回金额为人民币100.8827元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至2026年3月10日收市后，距离2026年3月19日（“新致转债”最后交易日）仅剩7个交易日，2026年3月19日为“新致转债”最后一个交易日。截至2026年3月10日收市后，距离2026年3月24日（“新致转债”最后转股日）仅剩10个交易日，2026年3月24日为“新致转债”最后一个转股日。特提醒“新致转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）投资者持有的“新致转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“新致转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.8827元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“新致转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“新致转债”二级市场价格（2026年3月10日收盘价为154.372元/张）与赎回价格（100.8827元/张）差异较大，债券持有人除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.53元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.8827元/每张）被强制赎回。投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

（五）如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

特提醒“新致转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

四、联系方式

联系部门：证券事务部办公室

电话：021-51105633

邮箱：investor@newtouch.com

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-020

天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月24日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金53,804.08万元。截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币19,389.55万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年2月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	87,870.00
减：直接支付发行费用	13,188.81
二、募集资金净额	74,681.19
减：	
以前年度已使用金额	44,156.84
本年度使用金额	9,647.24
现金管理金额	3,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.15
加：	
募集资金利息收入	2,012.59
三、报告期期末募集资金余额	19,389.55

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年2月24日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001822	19,231.48	使用中
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005262096	153.88	使用中
江苏金海通半导体设备有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301598875	4.19	使用中
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005261995	0	已注销
合计			19,389.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53,804.08万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月18日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

公司于2025年2月26日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年2月24日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
39,000	投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品	2024年3月18日	2025年3月17日	2024年3月18日
32,000	投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品	2025年2月26日	2026年2月25日	2025年2月26日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

受托人	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	实际收益或损失
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	238,000,000.00	2025年1月2日	2025年1月27日	2.30%	380,138.89
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	33,000,000.00	2025年1月2日	2025年2月12日	1.67%	61,904.38
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	250,000,000.00	2025年2月5日	2025年2月28日	2.05%	327,430.56
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	33,000,000.00	2025年2月20日	2025年3月26日	1.57%	48,261.37
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	254,000,000.00	2025年3月3日	2025年3月31日	2.30%	454,377.78
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	33,000,000.00	2025年4月1日	2025年5月12日	2.10%	77,843.84
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	254,000,000.00	2025年4月7日	2025年4月30日	2.40%	389,466.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	120,000,000.00	2025年5月12日	2025年6月12日	2.00%	200,000.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	33,000,000.00	2025年5月15日	2025年6月18日	1.70%	52,257.53
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	100,000,000.00	2025年5月26日	2025年6月26日	2.00%	166,666.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	120,000,000.00	2025年6月23日	2025年7月23日	1.85%	185,000.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025年6月24日	2025年7月28日	1.50%	48,904.11
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	90,000,000.00	2025年7月7日	2025年8月7日	1.85%	138,750.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025年7月31日	2025年9月3日	1.60%	52,164.38
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	120,000,000.00	2025年8月1日	2025年8月29日	2.00%	186,666.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	50,000,000.00	2025年8月11日	2025年9月11日	1.75%	72,916.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	150,000,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	1.75%	211,458.33
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025年9月11日	2025年10月15日	1.60%	52,164.38
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025年9月15日	2025年10月15日	1.70%	49,583.33
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	150,000,000.00	2025年10月9日	2025年10月31日	1.65%	151,250.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025年10月27日	2025年11月27日	1.65%	48,125.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025年10月30日	2025年12月3日	1.60%	52,164.38
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	130,000,000.00	2025年11月3日	2025年11月28日	1.65%	148,958.33
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	180,000,000.00	2025年12月1日	2025年12月31日	1.65%	247,500.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025年12月11日	2026年1月14日	1.60%	52,164.38

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”的内部投资结构，保荐机构出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金3,205.05万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

2026年3月10日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了金海通公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2026年3月10日，国泰海通证券股份有限公司针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《国泰海通证券股份有限公司关于天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。专项核查意见认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
2026年3月11日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年2月24日												
本年度投入募集资金总额	9,647.24												
已累计投入募集资金总额	53,804.08												
变更用途的募集资金总额	3,205.05												
变更用途的募集资金总额比例	4.29%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	研发项目	否	43,615.04	不适用	43,615.04	8,922.88	26,058.02	-17,557.02	59.75	2026年10月	不适用	不适用	否
年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	生产建设	是	11,066.15	7,861.10	7,861.10	724.36	7,633.06	-228.04	97.10	已终止（注1）	不适用	不适用	是
	其他-暂未确定投向			3,205.05	3,205.05	0	0	-3,205.05	0	暂未确定投向	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	补流	不适用	20,000.00	不适用	20,000.00	0	20,113.00	113.00（注2）	100.57	—	—	—	—
合计			74,681.19	—	74,681.19	9,647.24	53,804.08	-20,877.11	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”。												

注1：公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金3,205.05万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

注2：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2023年2月24日														
变更后的项目	对应原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	生产建设	江苏金海通半导体设备有限公司	江苏省南通市	7,861.10	7,861.10	724.36	7,633.06	97.10	已终止	不适用	不适用	不适用	2025年5月29日	2025年6月16日
暂未确定投向		其他-暂未确定投向	–	–	3,205.05	3,205.05	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用	2025年5月29日	2025年6月16日
合计					11,066.15	11,066.15	724.36	7,633.06	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。公司借此机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。 决策程序及信息披露情况：公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-023

天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例、每股转增比例：向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.50股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整现金分红、转增股份总额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处的半导体专用设备制造领域，对于持续研发的需求较高，资金需求量较大。本次利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润176,525,276.68元，其中母公司实现净利润190,126,272.31元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积金后截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为621,360,576.53元，资本公积余额为913,289,420.01元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、现金分红：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。截至2026年3月9日公司总股本60,000,000股，公司拟合计派发的现金分红总金额为22,800,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例12.92%。

2、资本公积转增股本：公司拟向全体股东以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.50股。截至2026年3月9日，公司总股本为60,000,000股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为87,000,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整现金分红、转增股份总额，具体调整情况将另行公告，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	22,800,000.00	9,905,089.10	10,191,171.38
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,525,276.68	78,481,491.79	84,794,096.91
本年度末母公司报表未分配利润（元）	621,360,576.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	42,896,260.48		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	113,266,955.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	42,896,260.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	37.87		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2025年，公司实现归属于母公司所有者的净利润176,525,276.68元，公司拟分配的现金红利总额为22,800,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。集成电路行业是技术密集、知识密集的高科技行业，对测试设备技术要求较高。为保持技术的先进性和产品的竞争力，集成电路测试设备需要进行持续的研发，从研发、试产、质控到市场推广和销售的各阶段，需要投入较高人力成本及研发费用等经常性开支，资金需求量较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处于成长阶段，公司将继续专注服务半导体封装测试行业，根据国家政策和战略发展需求，不断加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场，积极促进科技成果产业化。公司将继续加深与下游客户的合作，时刻把握市场动态，围绕自身技术优势，结合行业发展趋势，持续进行研发创新和技术升级。

（三）公司盈利水平及资金需求

2025年，公司实现归属于母公司所有者的净利润176,525,276.68元。公司业务仍在持续发展，为保障公司业务发展，公司有较高的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司坚持稳健的利润分配政策，在制定每年的分红政策时，会综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和长期价值回报。本次利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素而做出的合理安排，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场等，确保公司长期稳健发展，为股东创造长期稳定的回报。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持提升软、硬件研发能力，完善研发体系，提高团队专业化程度，提升生产运营效率以及深化公司核心竞争力，积极履行公司的利润分配制度，重视以现金分红形式对投资者进行回报，为全体股东带来更多的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年3月9日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案并修订<公司章程>的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及股东回报规划，符合公司实际情况。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案并修订<公司章程>的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-024

天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月9日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于增加预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

2026年3月10日，公司第二届董事会第二十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于增加预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事吴华回避表决。

公司董事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本次预计关联交易金额总额未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

为满足公司日常经营发展需要，公司拟新增与关联方南通华达微电子集团股份有限公司的日常关联交易事项，交易内容主要为公司向关联方出售半导体测试分选机及相关备品备件，本次预计新增日常关联交易金额合计不超过2,000万元，公司2026年度日常关联交易预计金额从17,440万元上升至19,440万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联方名称	2026年原预计额度（万元）	本次拟增加预计额度（万元）	本次增加后2026年预计总额度（万元）	2026年1月实际发生金额（未经审计）（万元）
向关联方销售商品	通富微电子股份有限公司	3,000		3,000	178.29
向关联方销售商品	苏州通富超威半导体有限公司	1,000		1,000	1.85
向关联方销售商品	南通通富微电子有限公司	4,000		4,000	2.78
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	1,000		1,000	198.31
向关联方销售商品	合肥通富微电子有限公司	2,000		2,000	
向关联方销售商品	通富通科（南通）微电子有限公司	5,000		5,000	58.50
向关联方销售商品	南通华达微电子集团股份有限公司	0	增加2,000	2,000	
向关联方租赁房产	上海新朋实业股份有限公司	1,440		1,440	85.36
小计		17,440	增加2,000	19,440	525.09

注1：上述关联交易在关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂，苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，前述6家公司为同一控制下的不同关联方，关联交易金额可以内部调剂；

注2：上表中，2026年1月实际发生金额均为含税金额；

注3：2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易；

注4：预计金额与实际发生金额差异较大的原因主要系对比期间不同所致。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过8,100万元的日常关联交易；同时，公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，预计与上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过1,440万元的日常关联交易。

2025年12月，公司第二届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关联交易预计总额度从8,100万元增加至9,600万元（增加预计总额度1,500万元），相关日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联方名称	2025年原预计额度（万元）	2025年内部调剂后的预计额度（万元）注2	前次增加预计额度（万元）	前次增加后2025年预计额度（万元）	2025年内部调剂后的预计额度（万元）注3	2025年实际发生金额（经审计）（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	通富微电子股份有限公司	1,000	2,700	增加1,000	3,700	3,700	3,213.76	/
向关联方销售商品	苏州通富超威半导体有限公司	500	100		100	100	75.61	/
向关联方销售商品	南通通富微电子有限公司	3,000	1,000		1,000	1,000	684.58	/
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	2,100	1,200		1,200	1,200	862.56	/
向关联方销售商品	合肥通富微电子有限公司	500	500		500	600	559.67	/
向关联方销售商品	通富通科（南通）微电子有限公司	1,000	2,600	增加500	3,100	3,000	2,529.15	/
向关联方租赁房产	上海新朋实业股份有限公司	1,440	1,440		1,440	1,440	1,045.61	/
小计		9,540	9,540	增加1,500	11,040	11,040	8,970.94	/

注1：上述关联交易在关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂，苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，前述6家公司为同一控制下的不同关联方，关联交易金额可以内部调剂；

注2：本列为公司根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；

注3：本列为公司根据2025年1-12月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；

注4：上表中，2025年实际发生金额均为含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

1.南通华达微电子集团股份有限公司

（1）关联人的基本情况

公司名称	南通华达微电子集团股份有限公司
统一社会信用代码	91320600138298807R
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	石明达
注册资本	2,000万元
成立日期	1990年10月11日
住所及主要办公地点	南通市紫琅路99号
主营业务	生产销售半导体分立器件，集成电路电子应用产品；经营本企业自产产品，成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿产品销售；自有房屋租赁，停车场服务（另设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（未经审计）	2026年1月31日（未经审计）
总资产	3,999,513,885.12	4,930,440,989.03
净资产	3,650,192,048.42	4,194,343,472.08
项目	2025年度（未经审计）	2026年1月31日（未经审计）
营业收入	299,597,659.2	31,424,557.73
净利润	96,922,695.86	544,161,573.56

（2）与公司的关联关系

南通华达微电子集团股份有限公司为公司5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，南通华达微电子集团股份有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：南通华达微电子集团股份有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司主要为南通华达微电子集团股份有限公司供应半导体测试分选机及相关备品备件，产品价格遵循市场化原则，由协议双方根据市场情况协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则。本次增加预计2026年度日常关联交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事、审计委员会已召开专门会议审议本次关联交易事项，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-022

天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议、于2026年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日的各项资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用及资产减值准备情况公告如下：

一、信用减值及资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计29,553,770.27元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	2025年1-12月计提减值准备金额	备注
1	信用减值准备	25,841,866.34	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值准备	3,711,903.93	存货跌价准备、合同资产减值准备
合计		29,553,770.27	

二、计提信用减值准备及资产减值准备的依据及说明

（一）计提信用减值准备的依据及说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年1-12月公司计提信用减值准备25,841,866.34元。

（二）计提资产减值准备的依据及说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司对截至2025年12月31日的存货项目进行了减值测试，2025年1-12月计提存货跌价准备3,606,663.18元。

2、合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对截至2025年12月31日的合同资产进行了减值测试，2025年1-12月公司计提合同资产减值准备105,240.75元。

3、固定资产、无形资产等长期资产减值

公司对存在减值迹象的固定资产、无形资产等长期资产，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可回收金额，并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。公司对截至2025年12月31日的固定资产、无形资产等长期资产进行了全面的清查和减值测试，固定资产、无形资产等长期资产无需计提减值准备。

三、对公司的影响

2025年1-12月，公司计提信用及资产减值准备合计29,553,770.27元，预计将减少公司2025年1-12月利润总额29,553,770.27元。公司2025年1-12月计提的减值准备已经会计师事务所审计。本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策要求，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提信用及资产减值准备的审议程序

本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并经公司第二届董事会第二十六次会议通过。

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会认为：本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况进行信用及资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
2026年3月11日